

**特点**

- 小封装尺寸可用于高密度装配 .
- 玻璃密闭封装 .
- 良好地适用于自动装配 .
- 采用无铅工艺合乎 RoHS 指令要求 .

**封装外形尺寸**

MiniMELF (SOD-80)

尺寸单位 : mm

**机械数据**

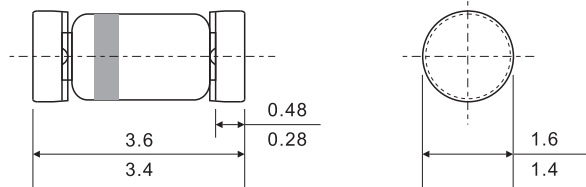
封装 : miniMELF (SOD-80) 玻璃封装

引脚易焊性标准 : GB4937-1995  
GB2423.28-82

极性 : 色环标志负极 .

安装位置 : 任意 .

重量 : 约 0.03 克



**绝对最大额定值**  $T_{amb} = 25^{\circ}C$  除非特别注明

参数项目	测试条件	符号	数值	单位
重复反向峰值电压		$V_{RRM}$	100	V
恒定 (直流) 反向电压		$V_R$	75	V
正向平均整流电流	阻性负载半波整流 $f \geq 50Hz, l = 8mm$	$I_o$	150	mA
峰值正向浪涌电流	$t < 1s, T_j = 25^{\circ}C$	$I_{FSM}$	500	mA
耗散功率	$T_L = 45^{\circ}C$	$P_{tot}$	440	mW
	$T_L \leq 25^{\circ}C$	$P_{tot}$	500	mW

**热特性**  $T_{amb} = 25^{\circ}C$  除非特别注明

参数项目	测试条件	符号	数值	单位
热阻 (结至环境)	$T_L = 25^{\circ}C$ 恒温	$R_{thJA}$	350	$^{\circ}C / W$
最高容许结温		$T_j$	175	$^{\circ}C$
贮存温度范围		$T_{stg}$	- 65 ~ 175	$^{\circ}C$

**电特性**  $T_{amb} = 25^{\circ}C$  除非特别注明

参数项目	测试条件	符号	最小值	典型值	最大值	单位
正向电压	$I_F = 10mA$	$V_F$	—	0.86	1	V
反向漏电流	$V_R = 20V$	$I_R$	—	—	25	nA
	$V_R = 20V, T_j = 150^{\circ}C$	$I_R$	—	—	50	$\mu A$
	$V_R = 75V$	$I_R$	—	—	5	$\mu A$
反向峰值击穿电压	$I_R = 100\mu A, t_p / T = 0.01$ $t_p = 0.3ms$	$V_{BR}$	100	—	—	V
结电容	$V_R = 0, f = 1MHz$	$C_{tot}$	—	—	4	pF
整流效率	$V_{HF} = 2V, f = 100MHz$	$\eta$	0.45	—	—	—
反向恢复时间	$I_R = I_F = 10mA, i_R = 1mA$	$t_{rr}$	—	—	8	ns
	$I_F = 10mA, V_R = 6V$ $i_R = 0.1 \times I_R, R_L = 100\Omega$	$t_{rr}$	—	—	4	ns

额定值及电特性参数曲线  $T_{amb} = 25^{\circ}C$  除非特别注明

图1 最大允许正向连续电流对环境温度

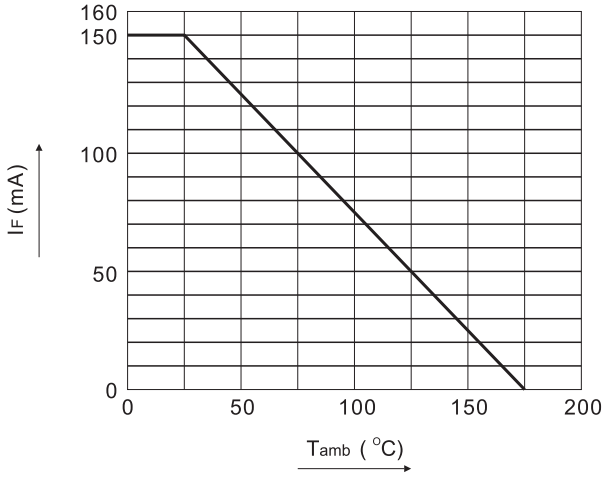


图2 瞬间正向特性曲线

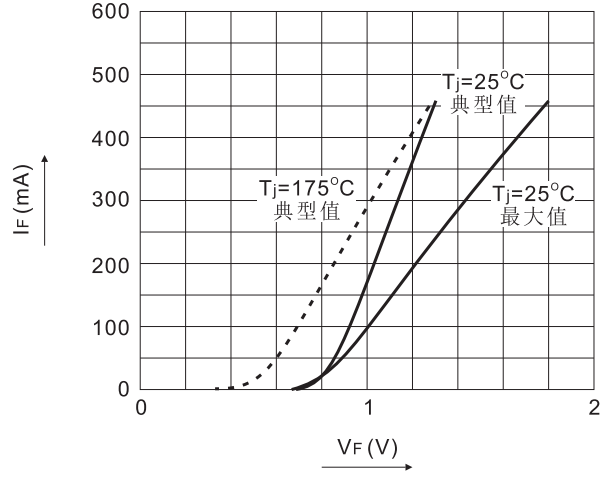


图3 最大允许连续反向电压对环境温度

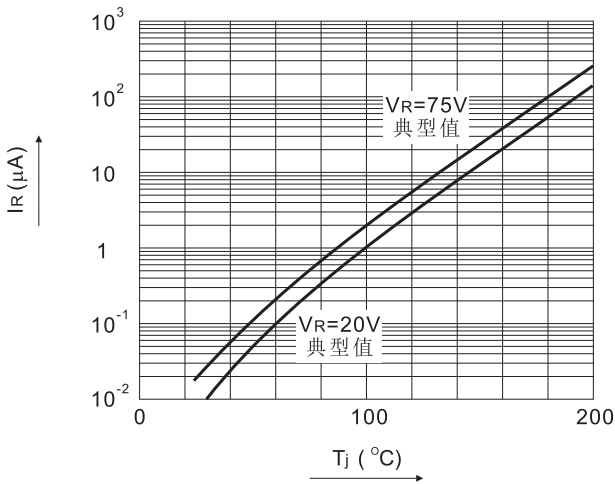


图4 电容比值对反向电压

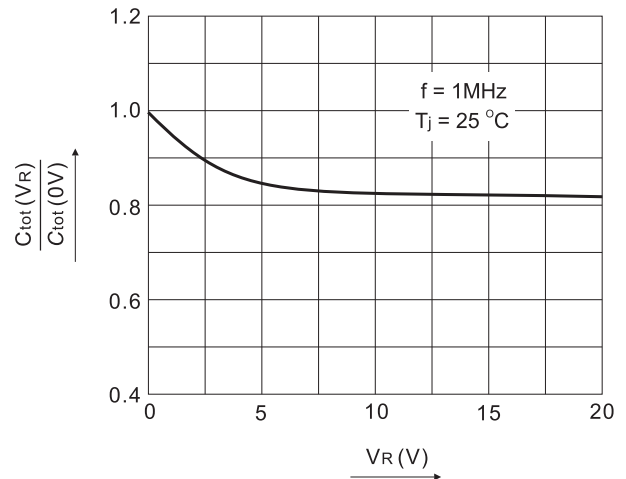


图5 容许重复峰值正向电流对脉冲宽度

